平成24年1月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年8月30日

上 場 会 社 名　菱洋エレクトロ株式会社　　上場取引所　東
コ ー ド 番 号　8068　　ＵＲＬ　http:// www.ryoyo.co.jp
代　　表　　者　(役職名)　代表取締役社長　　(氏名)　小川　賢八郎
問合せ先責任者　(役職名)　専務取締役管理本部長　　(氏名)　堀切　豊　　TEL 03-3543-7711
四半期報告書提出予定日　平成23年9月9日　　配当支払開始予定日　平成23年10月3日
四半期決算補足説明資料作成の有無　：有
四半期決算説明会開催の有無　：有(証券アナリスト、機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1．平成24年1月期第2四半期の連結業績(平成23年2月1日～平成23年7月31日)

(1) 連結経営成績(累計)　(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
24年1月期第2四半期	44,136	△5.9	799	25.7	909	17.4	520	3.2
23年1月期第2四半期	46,888	17.7	636	―	774	―	503	―

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
24年1月期第2四半期	19.47	―
23年1月期第2四半期	18.21	―

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
24年1月期第2四半期	73,442	62,405	85.0	2,335.72
23年1月期	72,857	62,227	85.4	2,329.00

(参考)自己資本　24年1月期第2四半期　62,405百万円　　23年1月期　62,227百万円

2．配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
23年1月期	―	15.00	―	15.00	30.00
24年1月期	―	15.00			
24年1月期(予想)			―	15.00	30.00

(注)当四半期における配当予想の修正有無　：無

3．平成24年1月期の連結業績予想(平成23年2月1日～平成24年1月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	95,000	0.7	1,400	2.3	1,600	1.1	930	△16.4	34.81

(注)当四半期における業績予想の修正有無　：無

４．その他　（詳細は、【添付資料】４ページ「その他」をご覧ください。）

（１）当四半期中における重要な子会社の異動　　：無
新規　― 社（社名　　）、除外　― 社（社名　　）
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用　：有
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
①　会計基準等の改正に伴う変更　　：有
②　①以外の変更　　：無
（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

（４）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数(自己株式を含む)	24年1月期2Q	29,800,000株	23年1月期	32,072,398株
②　期末自己株式数	24年1月期2Q	3,081,952株	23年1月期	5,353,962株
③　期中平均株式数(四半期累計)	24年1月期2Q	26,718,244株	23年1月期2Q	27,673,297株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …… 2
（１）連結経営成績に関する定性的情報 …… 2
（２）連結財政状態に関する定性的情報 …… 3
（３）連結業績予想に関する定性的情報 …… 3
２．その他の情報 …… 4
（１）重要な子会社の異動の概要 …… 4
（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 …… 4
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 …… 4
３．四半期連結財務諸表 …… 5
（１）四半期連結貸借対照表 …… 5
（２）四半期連結損益計算書 …… 7
（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …… 8
（４）継続企業の前提に関する注記 …… 9
（５）セグメント情報 …… 9
（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 …… 10
４．補足情報 …… 11
（１）品目別売上高 …… 11

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間における国内経済は、東日本大震災による被害が広範囲に及び、製造業を中心に景況の悪化がみられました。年後半からは、サプライチェーンの復旧や復興需要の高まりにより景気持ち直しの動きも予測されていますが、原発問題の長期化や円高の進行、欧米を中心に世界経済に対する懸念が広がるなど、先行きは依然不透明な状況が続いています。

当社グループが属するエレクトロニクス業界は、中国をはじめとする新興国需要に下支えされ、産業向けが引き続き堅調に推移しました。一方、生産調整が続く民生向けや震災による部材の調達難の影響が生じた自動車向けは低調でしたが、これらの市況につきましても、年後半に掛けて徐々に回復へと向かう見通しです。

このような環境の中で当社グループは、震災後の製品安定供給に引き続き尽力しながら、主力商品の各種半導体や、システム情報機器・ネットワーク関連商品等の販売、さらには中長期的な収益の拡大に向けた新規高付加価値ビジネスの開拓にも努めてまいりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は441億36百万円（前年同期比5.9％減）、営業利益は７億99百万円（前年同期比25.7％増）、経常利益は９億９百万円（前年同期比17.4％増）、四半期純利益は５億20百万円（前年同期比3.2％増）となりました。

売上高の品目別の概況は次のとおりです。

（半導体）

・集積回路の売上高は156億89百万円で、前年同期より41億63百万円（21.0％）減少しました。
これは、携帯電話向けメモリー及びＭＰＵ、ゲーム機向けメモリーが減少したためです。

・半導体素子の売上高は82億82百万円で、前年同期より６億86百万円（7.7％）減少しました。
これは、パソコン周辺機器向けセンサー製品や、携帯電話向けの高周波デバイスが減少したためです。

（システム情報機器）

売上高は162億18百万円で、前年同期より21億28百万円（15.1％）増加しました。
これは、パソコンやワークステーションなどのハードウェア製品の入れ替え需要が堅調に推移したことに加え、アミューズメント機器向け映像出力製品が増加したためです。

（電子部品他）

売上高は39億46百万円で、前年同期より30百万円（0.8％）減少しました。
これは、通信機器向けケーブルや液晶モジュールが減少したためです。

セグメントの業績概況は次のとおりです。

なお、第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しておりますが、同会計基準等適用後のセグメントの区分方法は、従来の所在地別セグメント情報の区分と同一であるため、前年同期比を記載しております。

（日本）

携帯電話向けメモリー及びＭＰＵが減少したことにより、外部顧客への売上高は377億49百万円となり、前年同期より14億１百万円（3.6％）減少しましたが、売上総利益率の向上と販売管理費の減少により営業利益は７億４百万円となり、前年同期より２億９百万円（42.5％）増加しました。

（アジア）

ゲーム機向けメモリーや通信機器向け液晶モジュールが減少したことにより、外部顧客への売上高は63億86百万円となり、前年同期より13億51百万円（17.5％）減少し、営業利益は１億16百万円となり、前年同期より19百万円（14.2％）減少しました。

なお、連結損益計算書上の営業利益の金額は、上記各セグメントの営業利益に加え、セグメント間の消去を含んでおります。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

①　資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の資産は734億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億85百万円増加しました。これは、主に現金及び預金が増加したことによるものです。

当第２四半期連結会計期間末の負債は110億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億６百万円増加しました。これは、主に支払手形及び買掛金が増加したことによるものです。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は624億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億78百万円増加しました。これは、主に為替換算調整勘定が増加したことによるものです。

②　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、運転資金の減少や有価証券の満期償還等により160億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ44億46百万円増加しました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益８億58百万円に加え、売上債権が15億36百万円減少したことによる運転資金の減少等により30億64百万円の収入となり、前第２四半期連結累計期間に比べ62億81百万円増加しました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の満期償還による収入20億円等により18億11百万円の収入となり、前第２四半期連結累計期間に比べ15億44百万円増加しました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により３億99百万円の支出となり、前第２四半期連結累計期間に比べ15百万円増加しました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

現時点においては、平成23年３月８日に公表した数値から変更ありません。

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① 簡便な会計処理

・ 棚卸資産の評価方法

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

・ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

ただし、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

該当事項はありません。

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

資産除去債務に関する会計基準の適用

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

	当第２四半期連結会計期間末 （平成23年７月31日）	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 （平成23年１月31日）
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	18,093	11,646
受取手形及び売掛金	25,258	26,806
有価証券	11,000	9,000
商品及び製品	11,388	11,071
繰延税金資産	130	163
その他	381	1,130
貸倒引当金	△24	△124
流動資産合計	66,229	59,693
固定資産		
有形固定資産	211	179
無形固定資産	256	269
投資その他の資産		
投資有価証券	5,502	9,445
その他	1,244	3,271
貸倒引当金	△2	△2
投資その他の資産合計	6,744	12,714
固定資産合計	7,212	13,163
資産合計	73,442	72,857
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	8,834	8,520
未払法人税等	312	262
未払消費税等	36	0
賞与引当金	110	156
その他	603	569
流動負債合計	9,898	9,508
固定負債		
退職給付引当金	893	903
繰延税金負債	133	100
その他	111	116
固定負債合計	1,138	1,121
負債合計	11,036	10,629

（単位：百万円）

	当第２四半期連結会計期間末 （平成23年７月31日）	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 （平成23年１月31日）
純資産の部		
株主資本		
資本金	13,672	13,672
資本剰余金	13,336	13,336
利益剰余金	39,488	42,052
自己株式	△3,639	△6,322
株主資本合計	62,857	62,738
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	609	609
繰延ヘッジ損益	△0	△0
為替換算調整勘定	△1,061	△1,120
評価・換算差額等合計	△451	△511
純資産合計	62,405	62,227
負債純資産合計	73,442	72,857

（２）四半期連結損益計算書
（第２四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成22年２月１日 至　平成22年７月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成23年２月１日 至　平成23年７月31日）
売上高	46,888	44,136
売上原価	42,824	40,116
売上総利益	4,064	4,019
販売費及び一般管理費		
給料及び賞与	1,351	1,279
賞与引当金繰入額	113	110
退職給付費用	112	103
賃借料	223	219
減価償却費	124	117
その他	1,504	1,388
販売費及び一般管理費合計	3,428	3,220
営業利益	636	799
営業外収益		
受取利息	87	68
受取配当金	13	21
持分法による投資利益	81	－
仕入割引	5	7
その他	16	23
営業外収益合計	205	121
営業外費用		
売上割引	2	1
為替差損	62	6
固定資産廃棄損	1	4
その他	0	0
営業外費用合計	67	11
経常利益	774	909
特別利益		
債務取崩益	675	－
貸倒引当金戻入額	－	101
特別利益合計	675	101
特別損失		
関係会社株式売却損	777	－
訴訟関連費用	35	8
貸倒損失	－	143
特別損失合計	812	151
税金等調整前四半期純利益	637	858
法人税、住民税及び事業税	39	274
法人税等調整額	94	64
法人税等合計	134	338
少数株主損益調整前四半期純利益	－	520
四半期純利益	503	520

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

	前第２四半期連結累計期間 （自　平成22年２月１日 至　平成22年７月31日）	当第２四半期連結累計期間 （自　平成23年２月１日 至　平成23年７月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	637	858
減価償却費	124	117
有形固定資産除売却損益（△は益）	2	4
為替差損益（△は益）	18	16
引当金の増減額（△は減少）	△239	△157
受取利息及び受取配当金	△101	△90
関係会社株式売却損益（△は益）	777	－
持分法による投資損益（△は益）	△81	－
売上債権の増減額（△は増加）	△2,449	1,536
たな卸資産の増減額（△は増加）	△2,131	△327
仕入債務の増減額（△は減少）	943	403
未払消費税等の増減額（△は減少）	△82	36
その他	△787	775
小計	△3,369	3,172
利息及び配当金の受取額	142	94
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	9	△203
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,217	3,064
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の償還による収入	2,000	2,000
有形及び無形固定資産の取得による支出	△53	△142
有形及び無形固定資産の売却による収入	0	0
投資有価証券の取得による支出	△6,002	△55
関係会社株式の売却による収入	4,320	－
その他	2	10
投資活動によるキャッシュ・フロー	267	1,811
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△414	△399
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△414	△399
現金及び現金同等物に係る換算差額	△119	△29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,484	4,446
現金及び現金同等物の期首残高	21,828	11,646
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,343	16,093

（４）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年７月31日）において当社グループは、半導体、システム情報機器及びその他の電子部品の販売を主たる事業とする専門商社で、それらの商品の種類・性質等も類似しておりますので、単一事業分野の営業活動として、他に開示基準に該当するセグメントはありませんので、その記載を省略しております。

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年７月31日）

	日本（百万円）	アジア（百万円）	計（百万円）	消去又は全社（百万円）	連結（百万円）
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	39,150	7,738	46,888	―	46,888
(2) セグメント間の内部売上高又は振替高	3,600	80	3,681	(3,681)	―
計	42,751	7,819	50,570	(3,681)	46,888
営業利益	494	135	630	6	636

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……シンガポール、香港、上海

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間（自　平成22年２月１日　至　平成22年７月31日）

	アジア	その他	計
Ⅰ　海外売上高（百万円）	9,001	59	9,060
Ⅱ　連結売上高（百万円）	―	―	46,888
Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（%）	19.2	0.1	19.3

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1) アジア……中国、香港、台湾、タイ、マレーシア　等

(2) その他……イギリス、スイス

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、半導体、システム情報機器及びその他の電子部品の販売を主たる事業とする専門商社であり、国内においては当社及び連結子会社１社、海外においてはアジア地域（シンガポール、香港、上海）に拠点をもつ連結子会社３社が、それぞれ販売を担当しております。

したがって、当社グループは販売体制を基礎とした地域別セグメントから構成されており、「日本」、「アジア」の２つを報告セグメントとしております。

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第２四半期連結累計期間（自　平成23年２月１日　至　平成23年７月31日）

（単位：百万円）

	報告セグメント			調整額（注１）	四半期連結損益計算書計上額（注２）
	日本	アジア	合計		
売上高					
外部顧客への売上高	37,749	6,386	44,136	－	44,136
セグメント間の内部売上高又は振替高	2,655	69	2,725	△2,725	－
計	40,405	6,456	46,861	△2,725	44,136
セグメント利益	704	116	820	△21	799

（注）１．調整額は、セグメント間取引消去であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月21日）を適用しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

平成23年２月23日開催の取締役会決議により、会社法第178条の規定に基づき、平成23年３月３日付で自己株式2,272,398株を消却いたしました。これにより、利益剰余金及び自己株式が26億83百万円減少しております。

４．補足情報

（１）品目別売上高

		前第２四半期連結累計期間 （自　平成22年２月１日 至　平成22年７月31日）		当第２四半期連結累計期間 （自　平成23年２月１日 至　平成23年７月31日）		増減額 （百万円）
		金額（百万円）	構成比（％）	金額（百万円）	構成比（％）	
半導体	集積回路	19,852	42.4	15,689	35.5	△4,163
	半導体素子	8,969	19.1	8,282	18.8	△686
	小　　計	28,822	61.5	23,971	54.3	△4,850
システム情報機器		14,089	30.0	16,218	36.8	2,128
電子部品他		3,977	8.5	3,946	8.9	△30
合　　計		46,888	100.0	44,136	100.0	△2,752